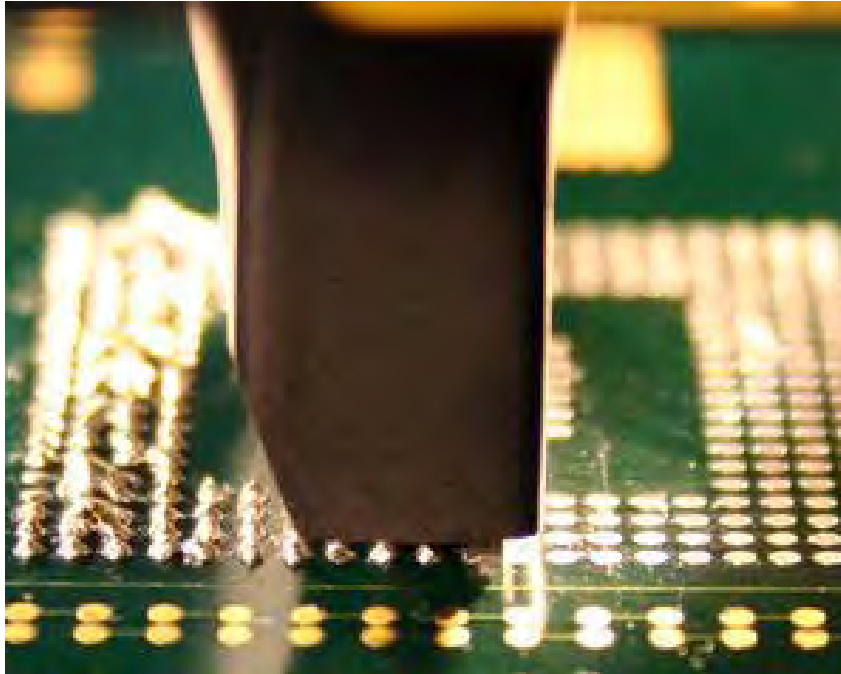


FINEPLACER® Lotabsaug-Modul



Das Lotabsaug-Modul erlaubt die präzise Restlotentfernung in inerter Atmosphäre*. Das aufgeschmolzene Lot wird mit kraftvollem Vakuum vom Board gesaugt, ohne dass Pads oder Lotstopplack in Mitleidenschaft gezogen werden.

Der softwaregesteuerte Prozess sorgt für reproduzierbare Ergebnisse. Je nach Bauteilgröße kann das Restlot in einem Durchgang abgesaugt werden. Auch dafür geeignet, BGA Interposers vor dem Reballen mit dem Reballing-Modul zu reinigen*.

Eine optional erhältliche Vakuumschiene (Bild 1) bietet dem Anwender zusätzliche Sicherheit bei der manuellen Restlotentfernung. Sie verhindert die ungewollte seitliche Bewegung entlang der X-Achse und schützt so umliegende Komponenten. Darüber hinaus setzt die Schiene einen mechanischen Endpunkt, um die Absaugbewegung auf der Y-Achse definiert zu stoppen.

Eigenschaften*

- Kontaktloses Lotabsaugen
- In einem Durchgang erledigt
- Sichere, sorgfältige und reproduzierbare Reinigung
- Inertgas-Atmosphäre
- Softwaregesteuert
- Minimale thermische Belastung
- Layout-spezifische Lotabsaugköpfe erhältlich

* je nach Konfiguration

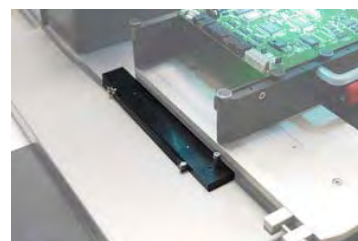


Bild 1